

**Halogen-free/High Tg/Low CTE/High Reliability**

**特性 (Feature)**

- 无卤, 无锑, 无红磷 Tg190°C  
Halogen, antimony and red phosphorous free
- 优良的耐热性  
Excellent thermal reliability
- 低的Z轴热膨胀系数  
Low Z-CTE
- 良好的耐CAF性能  
Anti-CAF capability

**应用 (Application)**

- 高端服务器  
High-end servers
- 背板  
Backpanel
- 无线通信设施  
Wireless communication infrastructure
- 高复杂度多层板  
High complexity multi-layers
- 高耐热汽车板  
Automotive applications requiring high thermal resistance

**板材性能 (Laminate Properties)**

Test Item 测试项目		Test Method (IPC-TM- 650) 测试方法	Test Condition 处理条件	Unit 单位	Specification 规格值 (IPC-4101E/130)	Typical Value 典型值	
Thermal 热性能	Thermal Stress 热应力	2.4.13.1	Float 288 °C/ Unetched	Sec	≥10	≥240	
	Glass Transition (Tg) 玻璃化转变温度	2.4.25	E-2/105 DSC	°C	≥190	201	
	CTE/ Z-Axis Expansion Z-轴热膨胀系数	2.4.24	Alpha 1	ppm/°C	≤60	36	
			Alpha 2	ppm/°C	≤300	210	
			50 - 260 °C	%	≤3.0	1.9	
	X/Y CTE X/Y-轴热膨胀系数	2.4.24	40 °C - 125 °C	ppm/°C	—	12/15	
	T-260	2.4.24.1	TMA	min	≥30	>60	
	T-288	2.4.24.1	TMA	min	≥15	>60	
TD(5% weight loss)	2.4.24.6	TGA	°C	≥340	412		
Flammability 燃烧性	UL94	E-24/ 23	Rating	V-0	V-0		
Electrical 电性能	Surface Resistivity 表面电阻	2.5.17.1	After Moisture Resistance	MΩ	≥10 <sup>4</sup>	5.0×10 <sup>8</sup>	
	Volume Resistivity 体积电阻	2.5.17.1	After Moisture Resistance	MΩ-cm	≥10 <sup>6</sup>	6.2×10 <sup>9</sup>	
	Dielectric Breakdown 击穿电压	2.5.6	D-48/ 50+D0.5/ 23	kV	≥40	65	
	Dielectric Constant 介电常数	2.5.5.2	Etched (RC50%)	@ 1 MHz	—	≤5.4	4.8
				@ 1 GHz	—	≤5.4	4.6
	Loss Tangent 介质损耗	2.5.5.2	Etched (RC50%)	@ 1 MHz	—	≤0.035	0.012
				@ 1 GHz	—	≤0.035	0.013
CTI 相对漏电起痕指数	IEC60112	A	V	—	>200		
Arc Resistance 耐电弧性	2.5.1	D-48/ 50+D-0.5/ 23	Sec	≥60	124		
Mechanical 机械性能	Peel Strength (1 oz.) 铜箔剥离强度	2.4.8	125 °C	N/mm	≥0.70	1.2	
			Float 288 °C/ 10 Sec		≥1.05	1.3	
			After Process Solution		≥0.80	1.1	
	Flexural Strength 抗弯强度	2.4.4	Length Direction	N/mm <sup>2</sup>	≥415	570	
			Cross Direction		≥345	520	
Moisture Absorption 吸水率	2.6.2.1	D-24/23	%	≤0.5	0.10		

### PI-520G 板材清单(Laminate List)

Thickness 厚度(mm)	Size 尺寸(Inch)	Copper foil Type 铜箔类型
0.05-3.20	37" x49" , 41" x49" , 43" x49" 74" x49" , 82" x49" , 86" x49"	Reverse treated copper foil RTF铜箔 : 1/3OZ—6OZ HTE copper foil HTE铜箔 : 1/3OZ—6OZ

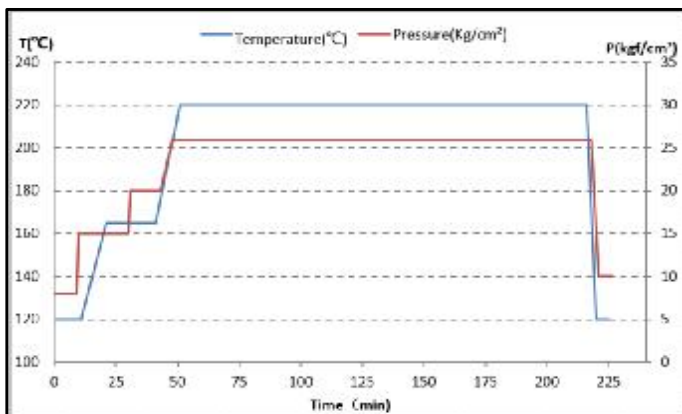
### PP-PI520G 半固化片清单(Prepreg List)

UL Designation UL型号	PP style 类型	R/C(%) 树脂含量	Dk±0.2(1GHz) 介电常数	Df±10%(1GHz) 介质损耗	Thickness(mil) 压合厚度
PP-PI520G	1037	72±2	4.0	0.016	2.0±0.30
		78±2	3.9	0.017	2.4±0.30
	106	68±2	4.1	0.015	1.8±0.30
		73±2	4.0	0.016	2.2±0.30
	1067	75±2	3.9	0.016	2.4±0.40
		68±2	4.2	0.014	2.3±0.30
	1080	74±2	4.0	0.016	2.9±0.50
		62±2	4.3	0.014	2.9±0.30
	1086	65±2	4.2	0.014	3.2±0.40
		68±2	4.2	0.014	3.5±0.50
	1086	64±2	4.2	0.014	3.4±0.40
		68±2	4.2	0.014	3.9±0.50
	3313	52±2	4.5	0.013	3.6±0.30
		55±2	4.4	0.013	3.9±0.40
		58±2	4.4	0.013	4.3±0.50
	2116	52±2	4.5	0.013	4.7±0.40
		54±2	4.5	0.013	5.4±0.40
		58±2	4.4	0.013	5.5±0.50
	1506	48±2	4.6	0.012	6.7±0.50
		50±2	4.5	0.012	7.0±0.50
7628	42±2	4.7	0.012	7.4±0.40	
	45±2	4.6	0.012	7.9±0.60	
	50±2	4.6	0.012	9.0±0.60	

### PP-PI520G 半固化片储存(Prepreg Storage)

储存条件(Condition)	有效期(Shelf Life)
Max. 50%RH & Max. 23°C 湿度 < 50% 及 温度 < 23°C	90 days
Max. 5°C(Normal in room temperature for at least 4h before using) 温度 < 5°C (拆包装前需在室温下回温至少4小时)	180 days

### 压合参数 (Recommended Process)



- Heat-up rate: 1.0-2.5°C/min (80°C-140°C)  
热压升温速率: 1.0-2.5°C/min (80°C-140°C)
- Curing time: >90min (>195°C)  
固化时间: >90min (>195°C)
- Curing pressure: 25±5kgf/cm<sup>2</sup> (vacuum hydraulic press) 固化压力: 25±5kgf/cm<sup>2</sup> (真空液压压机)